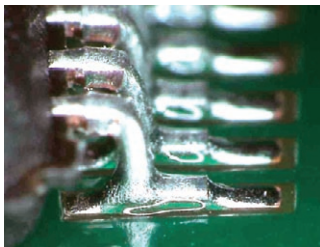


# 一般用ソルダーペースト Solder Paste for General Use

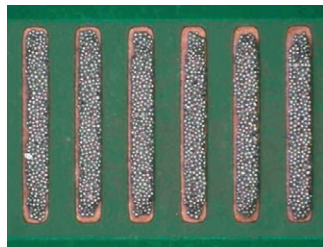
## LFSOLDER TLF-801-17 / TLF-401-11

### 低温系ソルダーペースト Low-Temperature Solder Paste series

#### TLF-801-17



QFPリードに対する優れたぬれ性  
Excellent wettability to QFP lead



0.4mmピッチの印刷性  
Printability of 0.4mm pitch

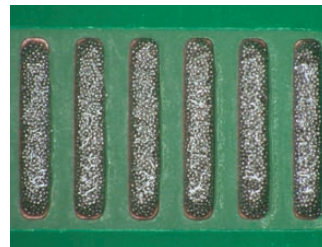
#### 特長

- 良好なぬれ性、はんだ付け性が得られます。
- 現行のリフロー条件の使用が可能です。
- ソルダーボールの発生が殆どありません。
- ファインピッチパターンに対し、優れた印刷性を示します。
- 保存安定性、連続印刷時の粘度安定性が良好です。

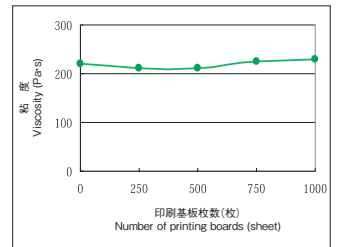
#### FEATURES

- Having a good solderability, adequate wettability.
- The current reflow conditions can be applied.
- Solder balls seldom generate.
- Excellent printability with fine patterns can be obtained.
- Stable printability is obtained with little change in viscosity during continuous printing.

#### TLF-401-11



0.4mmピッチの印刷性  
Printability at 0.4mm pitch



連続印刷時の粘度変化  
Change in viscosity at time of continuous printing

#### 特長

- 大気リフローではんだ付けが可能です。
- Sn/Pb共晶はんだより、低い温度のリフロー条件ではんだ付けが可能です。
- 連続印刷時の経時変化が少なく、安定した印刷性が得られます。
- はんだ付け性が良好で、各種部品に対しても十分なぬれ性を示します。

#### FEATURES

- It is possible to solder by air reflow.
- It is possible to solder by using lower temperature than Sn/Pb eutectic.
- Stable printability is obtained with little change in viscosity during continuous printing.
- Having a good solderability, adequate wettability is shown on various parts.

#### 一般特性 General Properties

項目	Item	TLF-801-17	TLF-401-11	試験方法 Test method
合金組成	Alloy composition (%)	Sn88.0/Ag3.5/Bi0.5/In8.0	Sn42.0/Bi58.0	JISZ3282 (1999)
融点	Melting point (°C)	195/ 209	139	DSC測定 DSC measurement
はんだ粒径	Solder Particle Diameter (μm)	20~41	25~45	レーザー解析 Laser analysis
フラックス含有量	Flux content (%)	11.5	9.5	JISZ3284 (1994)
塩素含有量	Chlorine content (%)	0.24	0.0	JISZ3197 (1999)
粘度	Viscosity (Pa·s)	220	210	JISZ3284 (1994)
チクソトロピー指数	Thixotropy index	0.58	0.59	JISZ3284 (1994)